



平成 25 年 11 月 7 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 新 川
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 西 村 浩
(コード番号 6274 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 経 営 企 画 部 長 森 琢 也
(電話番号 042-560-4848)

平成 26 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 26 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想を下記の通りお知らせいたします。

記

平成 26 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想数値（平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期 純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 修 正 予 想 (B)	6,100	△3,110	△3,030	△3,040	△167.26
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	—
増 減 率 (%)	—	—	—	—	—
(ご参考) 前期第 3 四半期実績 (平成 25 年 3 月期第 3 四半期)	10,411	△1,325	△1,068	△1,142	△62.86

業績予想の概要

エレクトロニクス業界においては、クラウドコンピューティングの普及に伴い、下期から一部の半導体メーカーでは、先端デバイスの量産に向けた設備投資が本格化すると予想されます。一方で、米国の政府財政問題などを背景とした消費者意欲の低下懸念や継続する新興国の成長率鈍化など、依然として半導体需要を左右する世界経済の下押し要因が散見されます。

このような状況のもと、直近の受注状況など、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第3四半期連結累計期間の業績予測を開示します。

なお、為替の想定換算レートは、95円/米ドルです。

※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は、様々な要因により、本資料における記述と大きく異なる可能性があります。

以 上